

國際半導體產業學院

國際半導體產業學院碩士班

入學學期		學位別	組別	授課語言
秋季班 春季班		碩士班		全英文授課
申請規定				
學系限制		-		
成績條件		-		
申請繳交文件		1. 必繳文件 (缺一則不予評審)	(1) 入學申請表 (2) 讀書計畫 (3) 最高學歷畢業證書 (若原文非中、英文者需經翻譯認證) (4) 最高學歷歷年成績單(包含分數等級、成績平均績點(GPA)、班級或校排名說明, 若原文非中、英文者需經翻譯認證) (5) 推薦信 1 份 (6) 英文語言能力證明： 須符合標準 TOEFL-PBT：500 ↑、TOEFL- iBT：73 ↑、IELTS (academic)：5.5 ↑、TOEIC：750 ↑ (7) 財力證明書(獎學金獲獎證明或銀行存款證明) (8) 護照或其他國籍證明文件 (9) 外僑居留證(若有)	
		2. 其他有利審查文件	中文語言能力證明	
		3. 系所要求文件	(1) 個人履歷 (2) 研究計畫	
甄選 方式	初試	書面審查：依申請人繳交書面資料綜合評量審查。 審查項目：在學表現、研究成果、研究潛力、其他表現。		
	複試	有，視訊面試（申請者依系所初試結果擇優進行複試，複試相關訊息由系所通知）。		
其他規定		-		
系所招生資訊				
系所簡介		國立陽明交通大學國際半導體產業學院以培育「國際化」及「產業化」之頂尖人才為教學宗旨，致力於半導體科技的創新與應用，研究著重於「半導體材料」、「固態電子元件」、「高階系統封裝」、「積體電路設計」及「異質系統整合封裝」等半導體領域，以研發下世代半導體製程技術及半導體晶片設計為發展重點。本學院採全英文教學，與國內外知名科技公司成立研究中心及合作計畫，並提供美國 UCLA、日本東京工業大學、比利時魯汶大學和印度理工學院等國際一流理工學校雙聯學位及國際合作機會。		
課程規劃		請參考國際半導體產業學院網站之課程介紹。 https://icst.nycu.edu.tw/?page_id=92&lang=en		
畢業生未來發展		1. 陽明交大國際半導體產業學院以培養具全球移動力之跨域高階人才為首要目標，研究著重於「半導體材料」、「固態電子元件」、「高階系統封裝」、「積體電路設計」及「異質系統整合」等半導體領域。 2. 學生畢業發展方向除了繼續攻讀半導體領域博士班外，在就業上均為半導體產業及電子產業渴求之人才，畢業生大多進入國際知名半導體企業及晶片設計公司之研發部門，如台積電(TSMC)、聯發科技(MediaTek)、瑞昱半導體(RealTek)、台灣高通(Qualcomm TW)及台灣美光記憶體(Micron)等，未來出路十分多元。		

系所網址	https://icst.nycu.edu.tw/			
行政人員				
聯絡資訊	姓名	林怡婷	電話	+886-3-5712121#55903
	Email	icst_ir@nycu.edu.tw	傳真	